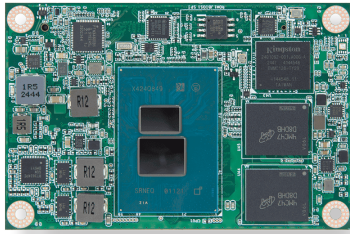


EmNANO-iX701



Intel® Amston Lake 凌动® 处理器迷你型 COM Express® Type 10 CPU 模块



特点

- 板贴 Intel Amston lake SoC 处理器
- 板贴 LPDDR5 SDRAM
- Intel® 2.5G 网络控制器
- 单通道 24-bit LVDS 和 1 x DDI 接口
- 支持 Intel® TCC (时间协调计算) 用于 Intel® 工业边缘控制

系统

CPU	板贴 Intel® 凌动® x7211RE 1.3GHz 双核 TDP 6W x7433RE 1.5GHz 四核 TDP 9W
内存	板贴 LPDDR5 4800MT/s 4GB / 8GB / 16GB SDRAM
BIOS	AMI UEFI BIOS
TPM	TPM2.0

I/O

USB 接口	8 x USB 2.0 接口 2 x USB 3.2 接口
扩展总线	4 x PCIe1, LPC, I2C, SMBus
存储	2 x SATA 3.0 接口 板贴 eMMC 5.1 (OEM 需求)
网络芯片	1 x Intel® i226 系列 2.5G 网络控制器
音频	HD 音频 link

显示

显示芯片	集成于 Intel® 第12代 UHD 核显
显示接口	LCD: 单通道 24-bit 通过 eDP 转 LVDS NXP PTN3460 1 x DDI 接口

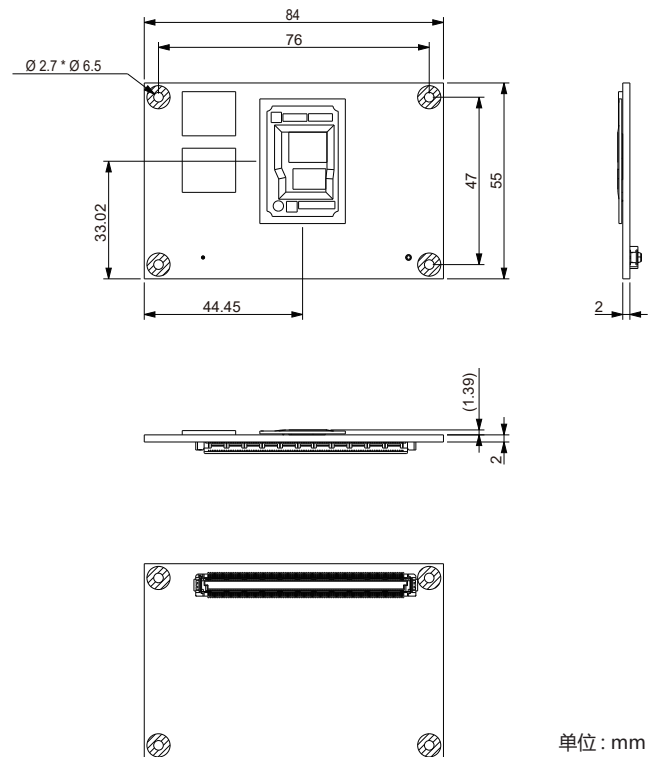
支持操作系统

Windows® 10/11 64-bit
Linux: Ubuntu

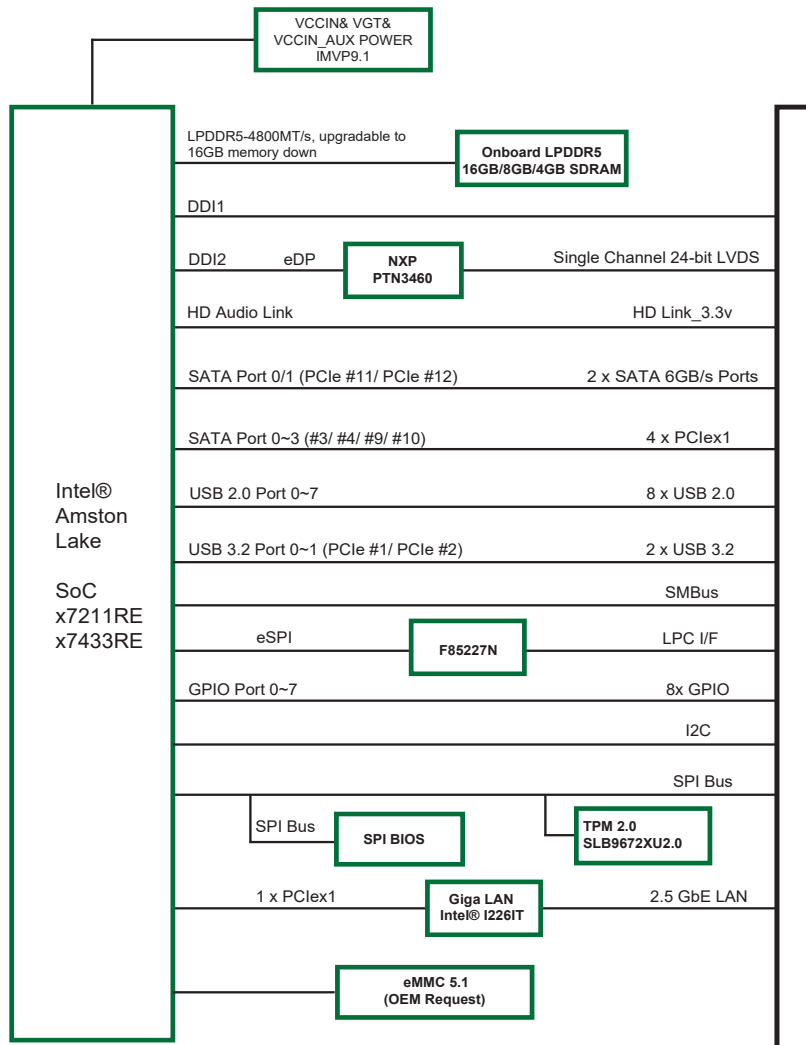
机构与环境

电源需求	5V/12V 自动检测
工作温度	-40°C ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度	10 ~ 95% @ 85°C (无冷凝)
尺寸 (L x W)	84 x 55 mm (3.3" x 2.17")

尺寸图



方框图



订货信息

EmNANO-iX701-WT-x7211RE-4G	迷你型 COM Express Type 10 Intel® Amston Lake 凌动 x7211RE CPU 模块带板贴 4G 内存, -40~85°C
EmNANO-X701-WT-x7433RE-8G	迷你型 COM Express Type 10 Intel® Amston Lake 凌动 x7433RE CPU 模块带板贴 8G 内存, -40~85°C
HS-X701-F1	导热器带螺纹支座
PBN-9007	COM Express Mini 评估载板 (EPIC 外型尺寸)
CBK-05-9007-00	线材包 1 x USB 线 1 x 串口线 1 x SATA 线 1 x SATA 电源线 1 x PS/2 线

* 备注：在 85°C 的操作过程中需要额外的鳍片型散热器。